

华泰联合证券有限责任公司

关于广州慧智微电子股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：慧智微
保荐代表人姓名：彭海娇	联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：张辉	联系电话：010-56839300

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对慧智微进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023 年 1-6 月，公司实现营业收入为 24,781.27 万元，较上年同期增长 20.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为-17,538.27 万元，净亏损较上年同期小幅收窄 1.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,316.54 万元，较上年同期亏损小幅增加 2.43%。截至 2023 年 6 月 30 日，发行人未分配利润金额为-72,782.66 万元，存在累计未弥补亏损，预计在未来一定期间内未弥补亏损将继续扩大。公司利润表现为亏损状态主要原因包括：（1）公司因实施股权激励报告期确认股份支付金额为 7,652.82 万元；（2）为保证产品能够紧跟下游应用市场的需求，缩小与龙头企业的技术差距，公司持续进行高额的研发投入，报告期内研发费用金额为 14,775.51 万元，占营业收入的比例为 59.62%，研发投入较高；（3）公司下游终端客户集中度较高，公司产品销售尚未形成突出的规模效应，同时全球经济增速放缓等外部因素影响使得公司主要下游应用智能手机市场需求疲软，市场竞争加剧，公司产品毛利空间受到挤压，盈利水平无法完全覆盖公司研发投入等各项支出。

上述问题不涉及整改事项。保荐人及保荐代表人提请公司做好相关信息披露

工作，及时充分地揭示相关风险，切实包含投资者利益；提请投资者特别关注上述事项引致的相关风险。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）技术风险

1、技术迭代的风险

无线通信从模拟通信进入数字通信，从 2G 通信进入 5G 通信，无线通信技术伴随着人们对更快通信速率的需求而不断迭代升级，也推动射频前端器件的不断更新，目前 4G 通信技术已经广泛的运用，5G 通信技术应用不断成熟。公司已经推出 4G、5G 频段（6GHz 以下频段）的射频前端产品，但若公司无法持续推出满足新一代通信技术要求的产品，有可能面临技术淘汰的风险。

此外，同代通信技术内也存在射频前端方案不断演进的情形，这要求射频前端厂商持续跟进最新射频前端方案，不断优化提升产品性能，实现产品迭代，从而通过最新一代产品的先发优势获得较大的市场份额和市场定价权。2023 年公司量产了 L-PAMiD 产品、低压 L-PAMiF 和低压 5G MMMB 产品，但是随着国产厂商陆续推出同类型产品，该款产品的市场竞争趋于激烈。当前 5G 射频前端产品向着高集成度、高性能、高性价比等方向进行迭代且速度较快，若公司的技术升级速度和产品迭代成果未达到预期水平，未能及时有效满足市场需求，则可能面临公司产品被替代或淘汰、新一代产品无法获得足够市场份额和定价权的风险。

2、研发失败的风险

公司自成立以来专注于底层技术架构创新，基于绝缘硅材料（SOI）和砷化镓材料（GaAs）的混合架构推出了可重构射频前端方案并成功商用，该技术架构亦需随着技术迭代不断升级并向更多的产品线拓展，以达到新技术的性能要求。若公司对自身技术开发能力判断失误、在研发过程中关键技术未能突破，有可能导致公司的核心技术架构无法适应最新的技术发展趋势，或者导致公司新产品无法满足客户需求、获得客户认同，公司的产品销售被延迟或无法顺利销售，公司将面临研发失败风险，导致前期研发投入无法收回，对公司持续发展和市场竞争

力造成不利影响。

公司的可重构技术具备快速迭代、高性价比、知识产权自主可控等特点，同时契合射频前端行业高复杂度和高集成度的发展趋势，使得公司 5G 产品取得一定竞争优势。但随着 5G 通信逐渐走向成熟，5G 射频前端方案将会逐渐稳定，射频前端行业内其他厂商的技术水平预计将会不断积累和提升，有可能导致公司在 5G 技术方面的竞争力下降，从而对公司的产品销售、定价能力、盈利水平等方面构成不利影响。

3、核心技术人才储备不足及人才流失的风险

半导体行业是典型的技术和人才密集型行业，尤其公司采用 Fabless 的经营模式，技术人才是公司的核心资产之一。随着公司规模快速扩大，产品线不断丰富，公司需要进一步吸纳优秀的技术人才，丰富公司技术团队的覆盖领域，形成优势互补、相互协作的团队配置。然而，射频芯片领域进入门槛较高，需要长期积累研发经验，优秀的研发人员较为稀缺；同时由于市场规模大、发展前景良好，射频芯片领域吸引了大量新的市场参与者进入，企业对人才的争夺日趋激烈。若公司缺乏对人才的吸引力，或者未能建立起对人才的有效激励体系，将难以引进更多的高端技术人才，甚至可能面临现有骨干技术人才流失的风险，进而对公司技术研发产生不利影响。

4、核心技术泄露的风险

长期以来公司以技术创新作为驱动力，自主研发了射频前端领域的核心技术，从而获得市场竞争优势。为避免核心技术泄露，保障经营过程中所积累的专利、IP 及技术的安全性，公司建立了较为完善的保密体系，例如与员工签署保密及竞业禁止相关协议、规范化研发流程管理以及申请集成电路布图设计专有权及发明专利保护等。

然而，上述体系不能完全排除因个别技术人员违反职业操守而泄密或者公司内控制度出现技术漏洞的情况，一旦核心技术泄密，可能给公司市场竞争力和生产经营带来负面影响。

（二）经营风险

1、公司产品应用于手机领域的业绩收入受单个机型项目出货规模和生命周期波动以及新旧项目切换影响较大的风险

公司产品目前主要应用于手机和物联网领域，主要终端客户包括 vivo、TCL、富智康等手机厂商以及闻泰科技、华勤通讯、中诺通讯和龙旗科技等 ODM 厂商。智能手机产品面向消费大众，受宏观经济发展、行业技术演变、产品迭代更新等因素影响较大，智能手机市场的景气程度和导入的机型项目出货量会影响手机厂商或者 ODM 厂商对公司产品的采购需求。报告期内，公司与品牌客户处于逐步深化合作的阶段，因此报告期内公司的业绩受单个机型项目的收入、利润贡献影响较大。如果公司在未来的生产经营中，不能持续导入手机品牌机型，或者导入的手机品牌机型出货规模较小，或者新旧项目切换未及时接续等，都可能导致公司营业收入、利润出现大幅波动，从而导致公司经营业绩存在大幅波动的风险。

2、公司业务规模和行业龙头存在较大差距的风险

业务规模方面，目前全球射频前端市场仍由 Skyworks、Qorvo、Broadcom、Qualcomm 和 Murata 等美系和日系厂商占据主导地位，国际龙头厂商在射频前端领域的年营收规模达到数十亿美元级别，盈利能力强，产品线全面，占领了全球的主要高端市场，且该等国际龙头厂商具有深厚的技术积累和强大的资金实力，每年均投入巨额的研发费用以维持其产品竞争力，保持其相对领先的市场地位。根据 Yole 数据，2022 年全球前五大射频前端厂商的合计市场份额为 80%。国产射频前端厂商中卓胜微、唯捷创芯的 2022 年年报显示，2022 年营业收入分别为 36.77 亿元和 22.88 亿元，公司与国内主要竞争对手相比具有一定的规模劣势。

3、主要产品客户验证和市场开拓失败或者进度不及预期的风险

通常而言，公司产品在导入终端客户进行批量销售之前，需经过终端客户的验证流程，终端客户验证通过后，该产品即可进入终端客户的供应商物料库，可供终端客户具体机型在实际应用时进行选用。产品初次导入头部客户机型，从最开始的接洽产生合作意向到产品最终验证导入的时间较长，一般历时 8 个月至一年半不等。同时，头部客户出于对自身产品质量、品牌声誉等因素的考虑，一般在产品导入初期会先从少数项目开始合作。在产品顺利导入量产、合作项目稳定发展一段时间后，通常会体现出客户粘性较高的特点，且随着销售规模的扩大，双方之间的合作进入良性循环，为持续推进新项目、推出新产品创造良好条件。因此，主要产品在客户的验证导入是公司产品性能与技术水平的重要体现，也是公司市场开拓的重要基础。

头部品牌终端客户具有采购规模大、产品系列广、高端需求多、品质管控严格等特点，在公司的收入和盈利中占比逐渐提升，对推动公司未来的收入增长、盈利提升起到越来越重要的作用。目前，公司正在积极拓展国内外一线品牌终端客户，持续深化与该等头部客户的合作关系。但是射频前端产品验证周期较长，且头部客户处于 5G 渗透率不断提升的阶段，产品需求紧跟射频前端方案的最新演进趋势，市场开拓的周期、成效也受到客户整体战略规划、市场偏好及竞争对手等多重因素的影响，若公司未能准确把握下游客户的应用需求，主要产品在终端客户中验证失败或者导入进度不及预期，将导致客户开拓进展低于预期或者客户拓展失败或者现有客户关系发生不利变化的风险，公司将无法在头部品牌终端客户中提升销售份额或丧失当前的有利地位，进而对公司持续竞争力、成长性及未来经营业绩产生不利影响。

4、委外生产模式的风险

公司采用行业通行的 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发、设计和销售环节，将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。

尽管 Fabless 经营模式已经成为行业惯例，但是若上游晶圆代工厂、基板代工厂、封测代工厂出现工艺变更，可能导致公司需要切换新的代工厂或重新进行新工艺磨合，需要消耗较长的时间，从而影响公司经营稳定性；此外，若发生晶圆代工厂、基板代工厂、封测代工厂等产能短缺、产品提价或其他突发性风险，可能导致公司无法获得足够的产能支持或采购成本上升，从而对公司日常经营和盈利能力造成不利影响。

5、客户集中度较高的风险

由于公司的下游终端应用领域主要包括智能手机和蜂窝物联网设备等，下游客户的市场集中度较高，导致报告期公司的客户呈现较高的集中度。

因客户集中度较高，若公司在新客户开拓方面未能及时取得成效，或公司目前服务的客户经营情况和竞争地位发生不利变化，或因公司产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生不利变化，将对公司的稳定盈利带来不利影响。

6、供应商集中度较高的风险

公司的供应商主要包括晶圆代工厂、基板代工厂和封测代工厂等。一方面，

由于上述代工行业资本投入大、技术门槛高，行业集中度较高，且公司主要采用的绝缘硅和砷化镓材料相关工艺为特殊工艺，晶圆代工产能供应规模明显小于传统的体硅 CMOS 工艺，能够满足公司技术及生产需求的晶圆制造及封测供应商数量有限；另一方面，由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛高，芯片设计公司出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别代工厂进行合作，因此公司的上游供应商集中度较高。

目前公司与主要供应商均保持稳定的合作关系。若公司的主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，或由于其他不可抗力因素不能与公司继续进行业务合作，可能影响公司产品的正常生产和交付进度，对公司生产经营产生不利影响。

7、产品质量风险

公司的射频前端模组产品主要用于无线通信的信号发射或接收，直接影响智能终端的信号收发质量，在终端应用中具有举足轻重的作用，客户对公司产品的质量及可靠性要求较高。公司与全球领先的代工厂合作，而且产品在成品入库前均会进行较为严格的品质测试，保证了较高的质量标准。但若未来公司在产品持续升级迭代、新产品开发过程中不能达到客户质量标准，或上游供应商提供的产品或者服务出现质量及可靠性问题，可能损害公司的品牌声誉，对公司与下游客户的合作产生不利影响。

（三）内控风险

1、实际控制人持股比例较低导致控制权变化的风险

公司首次公开发行股票并在科创板上市后，李阳、郭耀辉合计控制公司的表决权比例为 28.27%。虽然李阳、郭耀辉及其实际控制的主体、一致行动人均出具所持股份上市后锁定 36 个月的承诺，但公司实际控制人控制股权比例较低，存在公司控制权不稳定的风险，可能会对公司业务开展和经营管理的稳定产生不利影响。

2、经营规模发展迅速而导致的管理风险

随着未来公司业务持续发展和募投项目的实施，公司的收入、资产规模预计将进一步扩大，员工人数也将相应增加，将对公司的经营管理、产品研发、质量管控、市场开拓和内部控制等方面提出更高的要求。

如果公司的组织模式、管理制度和运营水平未能随业务规模扩大及时优化及提升,将使公司一定程度上面临生产经营效率降低的管理风险,进而对公司的持续发展造成不利影响。

3、内控体系建设及内控制度执行的风险

公司根据现代企业管理的要求,已经建立了符合科创板上市公司要求的内部控制体系,但上述制度及体系的实施时间较短,仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善。若公司有关内部控制制度不能有效贯彻和落实,将直接影响公司生产经营活动的合规性以及运行效率,进而影响公司经营管理目标的实现。

(四) 财务风险

1、毛利率波动以及未来提升不及预期的风险

公司的产品包括 5G 模组和 4G 模组,主要应用于手机和物联网领域。报告期内,公司综合毛利率为 16.95%。公司产品毛利率水平主要受产品结构、产品售价与成本等因素综合影响。公司产品销售单价受市场供求关系、同行业厂商竞争策略、产品及技术的先进性、产品更新迭代、终端客户议价能力、过往销售价格以及公司的战略布局等因素的共同影响;产品单位成本亦受原材料及封测服务的采购单价以及产业链供需关系等因素影响,均存在一定的不确定性。若公司未能正确判断下游需求变化或者公司技术实力未跟上市场需求变化,未能根据市场需求及时迭代升级现有产品或推出符合市场趋势的新产品,或者因公司产品市场竞争格局发生变化、抢占市场份额导致销售价格持续下降,或者未来原材料或封装测试服务产能供给紧张导致采购价格上涨,公司不能有效控制产品成本,均可能导致公司毛利率水平波动甚至下降、或者未来提升不及预期的风险,对公司盈利能力产生不利影响。

2、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、库存商品、委托加工物资及在途物资构成。报告期末,公司存货账面价值为 50,972.57 万元,占流动资产的比例为 22.57%。随着公司业务规模的不断扩大,公司存货绝对金额随之上升。若公司无法准确预测市场需求和管控存货规模,则可能面临因市场环境发生变化而导致的存货跌价的风险。

3、经营活动现金流量净额为负的风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-6,490.38万元，主要原因系公司业务处于快速发展阶段，随着4月、5月客户需求修复以及新增客户项目的预测，公司加大备货力度，采购齐套物料，有序安排生产经营。如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，且公司未能通过其他渠道筹集资金补充营运资金，将对公司的经营发展产生不利影响。

4、税收优惠政策变动的风险

截至目前，公司及全资子公司尚睿微电子（上海）有限公司享受有高新技术企业所得税优惠，如果未来公司无法满足税收优惠政策要求或税收优惠政策发生变化，可能对公司的盈利状况产生一定影响。

（五）法律风险

1、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，涉及专利、集成电路布图设计和软件著作权等众多知识产权。公司通过申请专利、与员工签署保密及竞业禁止相关协议等方式对自主知识产权进行保护，该等知识产权对公司持续经营具有重要意义，但无法排除关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，避免侵犯他人知识产权，但无法避免竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略，从而阻碍公司正常业务发展，也不排除公司与竞争对手或第三方产生其他知识产权纠纷的可能。此外，虽然公司已经在境外拥有注册专利，但是仍可能因国别和法律体系的不同导致对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解各国知识产权保护法律的内涵和规定，也可能会因此在其他国家引发争议和诉讼的风险。

2、技术授权风险

公司技术和产品研发的过程中需要使用电子设计自动化软件（EDA），并取得相关EDA供应商的技术授权。集成电路芯片设计行业中，EDA市场目前形成了寡头竞争的格局，主要国外厂商的EDA工具在其细分功能领域没有可靠的替代性产品。如果EDA供应商取消对公司技术授权，将导致研发和生产活动无法正常开展，对公司业务和经营产生重大不利影响。

（六）其他风险

1、产业政策变化的风险

半导体行业是国民经济和社会发展的战略性产业，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体行业的发展，增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，公司的经营情况将会面临更多的挑战，可能对公司业绩产生不利影响。

2、国际贸易摩擦风险

近年来，国际贸易摩擦不断升级，集成电路产业成为贸易冲突的重点领域，有关国家针对半导体设备、材料、技术等相关领域颁布了一系列针对中国的出口管制政策。集成电路是高度全球化的产业，如果国际贸易摩擦进一步加剧，从上游供应链来看，公司主要晶圆代工厂、EDA 软件供应商系境外企业，可能因为国际贸易政策的因素对公司相关采购产生不利影响；从下游应用领域来看，公司客户可能会因为贸易摩擦受到不利影响，进而影响到公司向其销售各类产品，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

三、重大违规事项

2023 年上半年，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年上半年，公司主要财务数据及指标情况如下：

单位：万元

主要财务数据	2023年1-6月/ 2023年6月30日	2022年1-6月/ 2022年12月31日	增减幅度（%）
营业收入	24,781.27	20,581.57	20.41
归属于上市公司股东的净利润	-17,538.27	-17,756.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,316.54	-17,881.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,490.38	-21,232.06	不适用
归属于上市公司股东的净资产	235,500.46	142,553.02	65.20
总资产	255,233.54	159,152.76	60.37
基本每股收益（元/股）	-0.43	-0.45	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.43	-0.45	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.46	-0.45	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-11.33	-11.67	增加0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.84	-11.75	减少0.09个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	59.62	65.01	减少5.39个百分点

注：以上数据未经审计或审阅。

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、2023 年上半年，公司营业收入为 24,781.27 万元，较上年同期增长 20.41%，主要系本期品牌客户渗透率提升，客户项目出货量提升所致。

2、2023 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为-17,538.27 万元，净亏损较上年同期收窄 1.23%，主要系销售业务量同比增加、期间费用同比下降所致。

3、2023 年上半年，公司经营活动产生的现金流量为-6,490.38 万元，经营活动产生的现金流量净流出同比减少 69.43%，主要系公司本期原材料采购下降所致。

4、2023 年上半年，公司归属于上市公司股东的净资产同比增长 65.20%，公司总资产同比增长 60.37%，主要系公司首次公开发行上市收到的募集资金所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。公司具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力，技术体系以功率放大器 (PA) 的设计能力为核心，兼具低噪声放大器 (LNA)、射频开关 (Switch)、集成无源器件滤波器 (IPD Filter) 等射频器件的设计能力，产品系列覆盖的通信频段需求包括 2G、3G、4G、3GHz 以下的 5G 重耕频段、3GHz~6GHz 的 5G 新频段等。

自 2011 年成立以来，公司一直专注于射频前端芯片领域，基于多年的技术积累，提出可重构射频前端平台，采用基于“绝缘硅 (SOI) + 砷化镓 (GaAs)”两种材料体系的可重构射频前端技术路线。

(一) 深度布局 5G 射频前端产品线：持续迭代 5G 全频段完整方案，推出多个新产品组合

公司于 2020 年成功量产 5G 新频段 (3GHz~6GHz) L-PAMiF 全集成发射接

收模组，逐步完善 5G 新频段单频和双频的 L-PAMiF、L-FEM 等完整产品方案组合，同时推出了 5G 重耕频段（Sub-3GHz）发射模组，一起构成 5G 的完整射频方案。

公司持续保持在 5G 射频前端模组领域的市场地位，成功量产了 5G 重耕频段 L-PAMiD 产品、5G 新频段小尺寸高集成 n77/n79 双频 L-PAMiF 产品、5G 新频段高性价比的 n77 单频 L-PAMiF 与 L-FEM 产品、支持 5G 全频段低压 PC2 的 L-PAMiF 和 MMMB PA 产品，获得更优功耗、更高性能以及更低成本的领先优势。同时公司也积极在 5G 重耕频段接收模组、物联网新形态等领域开发更多产品。

（二）客户资源优势：公司已经覆盖国内外头部智能手机品牌、ODM 厂商及物联网客户，市场地位不断提升

公司的射频前端模组产品已经在三星、vivo、OPPO、荣耀等国内外头部智能手机中大规模量产，并进入闻泰科技、华勤通讯和龙旗科技等一线移动终端设备 ODM 厂商，拥有优质的客户结构和客户基础。基于完整的射频前端模组方案，公司预计将继续在手机领域保持增长。

公司积极布局物联网领域，大力拓展 LTE Cat.1 蜂窝连接领域的市场机会。目前，公司 5G 全频段产品在移远通信、广和通和日海智能等头部无线通信模块厂商的规模量产，推动 5G 在物联网领域的规模应用。公司与头部无线通信模块厂商进行深度合作，成功开发出适用于 5G 通信模块需求的小尺寸、低成本、高性能的产品，未来将在 5G RedCap 物联网、NTN、车载等领域继续合作，共同制定并推出更有市场竞争力的方案。

（三）技术优势：公司自主研发推出可重构射频前端平台，持续加大研发投入，加快新技术布局

随着通信制式的发展，5G 增强技术、ENDC（非独立组网双连接）、DSDA（双卡双通）、NTN 手机直连卫星等需求日益凸显，对射频前端模组也提出了更高的要求。公司基于可重构射频前端的技术优势，持续加强研发投入，特别是新技术的布局。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已取得专利 121 项（其中发明专利 102 项），集成电路布图设计专有权 124 项。

公司 2023 年发布 5G 新频段小尺寸高集成 n77/n79 双频 L-PAMiF 产品，创

新性地把 n77/n79 (3.3GHz~5GHz) 超宽带做成单路的 PA、LNA、滤波器，支持低压 PC2 高功率，性能进一步提升。在高集成射频模组研发过程中，积累更先进的联合仿真技术、封装技术以及全系统的验证评估经验，为公司 Sub-3GHz 的 L-PAMiD 产品量产提供保障。

(四) 供应链优势：公司的混合架构优势使得晶圆供应更加灵活，并带来一定的成本和集成度优势

公司的射频前端混合架构采用绝缘硅和砷化镓工艺，集成度更高。成熟的绝缘硅工艺代工产能供应相对砷化镓更为充足和灵活，有利于实现供应链的多元化和差异化，避免了单一供应环节的过度集中。相对传统技术路线，公司的技术路线不使用体硅 CMOS 工艺的控制器的，因此不受体硅 CMOS 产能波动的影响；使用更少的砷化镓，在行业整体产能趋紧时，能更好的保障供应的稳定性。在供应商选择上，公司与头部晶圆代工厂、封测代工厂、滤波器厂商和基板代工厂展开深度合作，有利于充分保障公司的产品质量。同时，公司也积极与晶圆代工厂、封测代工厂等供应商一起联合开发更适用于公司的新工艺和新流程，进一步提升公司产品在性能和可靠性上的竞争力。

(五) 团队优势：公司打造了一支经验丰富的研发团队，积累了全系列的产品开发先进技术

公司核心技术团队的行业经验丰富。自 2011 年成立以来，在核心技术团队的带领和培养下，公司打造了一支经验丰富且兼具砷化镓器件设计能力、绝缘硅器件设计能力、基板设计能力、集成化模组设计能力的完整研发团队。截至 2023 年 6 月 30 日，公司的研发团队成员共计 209 人，主要成员拥有多年研发经验，可同时支撑超过 10 个中大型研发项目。

综上所述，2023 年半年度公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。2023 年 1-6 月，公司研发投入为 14,775.51 万元，较 2022 年 1-6 月同比增长 10.43%，研发投入占营业收入比例为 59.62%，较 2022 年 1-6 月减少 5.39 个百分点。

公司作为技术型企业，研发方向高度重视客户需求和行业技术发展趋势，截

至 2023 年 6 月 30 日，公司累计拥有 102 项发明专利、19 项实用新型专利、124 项集成电路布图设计专有权。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,430.05 万股，每股发行价格 20.92 元，本次募集资金总额为人民币 113,596.65 万元，扣除各项发行费用人民币 10,763.76 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 102,832.89 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验（2023）7-58 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（万元）
募集资金总额	113,596.65
减：券商不含税承销费，发行费等	7,593.87
收到募集资金总额	106,002.78
加：2023 年半年度专户利息收入	23.85
减：支付部分发行费用（不含增值税）	2,077.36
投入募集资金项目金额	3,645.49
发行手续费支出	0.71
购买理财产品净支出	65,000.00
募集专户 2023 年 6 月 30 日余额	35,303.08

注1：“收到募集资金总额”与“（四）本报告期内募集资金的使用情况”之“3、募投项目的资金使用情况”之“调整后拟投入募集资金金额”之间的差异为除券商承销费用及部分发行费以外的其他发行费用（不含增值税）。

注2：投入募集资金项目金额与“（四）本报告期内募集资金的使用情况”之“3、募投项目的资金使用情况”之“截至期末累计投入募集资金总额”的差异为待置换的自筹资金预先投入募投项目金额 22,568.26 万元。

（三）募集资金专户存储情况

公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资

金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（万元）
广州慧智微电子股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000109898368	9,879.37
广州慧智微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907293110609	25,423.71
广州慧智微电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	82210078801300002219	-
尚睿微电子（广州）有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120921148710909	-
尚睿微电子（上海）有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120915245810906	-

注：公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号为82210078801300002219。基于公司本次公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额的情况，结合募集资金投资项目的实际情况，公司决定将该账户终止使用并注销。2023年6月27日，公司、保荐人和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》。截至2023年6月30日，公司尚未完成上述募集资金专户注销手续。

（四）本报告期内募集资金的使用情况

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年6月1日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币69,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐人出具了核查意见。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币65,000.00万元，具体情况列示如下：

购买主体	签约银行名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率
广州慧智微电子股份有限公司	平安银行广州分行营业部	大额存单	15,000.00	2023年6月8日	2026年6月8日	3.20%
广州慧智	平安银行	结构性存款	3,000.00	2023年	2023年8	1.75%-

微电子股份有限公司	广州分行营业部			6月9日	月9日	2.82%
广州慧智微电子股份有限公司	平安银行广州分行营业部	结构性存款	14,000.00	2023年6月9日	2023年9月12日	1.75%-2.92%
广州慧智微电子股份有限公司	平安银行广州分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023年6月9日	2023年7月17日	1.75%-2.77%
广州慧智微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	结构性存款	15,000.00	2023年6月7日	2023年9月7日	1.65%-2.95%
广州慧智微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	结构性存款	15,000.00	2023年6月7日	2023年7月7日	1.65%-2.85%

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年6月27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币23,186.02万元，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具《关于广州慧智微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）7-565号）。保荐人对上述事项发表了核查意见。

3、募投项目的资金使用情况

公司于2023年6月27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐人对上述事项发表了核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年 1-6 月使用募集资金金额为 5,842.18 万元，累计使用募集资金为 26,213.75 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：万元

项目类型	序号	募投项目	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	2023 年 1-6 月使用金额	截至期末累计投入募集资金总额
芯片测试中心建设	1	芯片测试中心建设	25,782.36	25,782.36	-	-	-
总部基地及研发中心建设	2	总部基地及广州研发中心建设项目	47,304.43	47,304.43	37,000.00	3,087.33	21,973.44
	3	上海研发中心建设项目	27,331.99	27,331.99	20,000.00	698.55	2,184.00
补充流动资金	4	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	45,832.89	2,056.30	2,056.30
合计			150,418.78	150,418.78	102,832.89	5,842.18	26,213.75

综上所述，公司 2023 年 1-6 月募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定；公司 2023 年 1-6 月对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司上市以来，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股情况未发生变动。截至 2023 年 6 月 30 日，慧智微实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)	合计持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	李阳	董事长、总经理	3,258.12	993.44	4,251.56	9.3956
2	郭耀辉	董事、副总经理	1,853.59	688.97	2,542.56	5.6188
3	张帅	董事	-	-	-	-
4	薛爽	独立董事	-	-	-	-

5	李斌	独立董事	-	-	-	-
6	张丹	监事会主席	-	18.80	18.80	0.0415
7	金玉华	监事	-	11.60	11.60	0.0256
8	潘丽凤	职工代表监事	-	12.40	12.40	0.0274
9	徐斌	财务总监、 董事会秘书	-	210.00	210.00	0.4641

公司控股股东、实际控制人为李阳和郭耀辉。李阳、郭耀辉合计直接持有发行人 11.30%的股份，通过慧智慧资、横琴智古、Zhi Cheng、慧智慧芯、横琴智往、横琴智今、横琴智来等持股平台控制发行人 14.69%的表决权，同时通过与奕江涛、王国样的一致行动关系控制发行人 2.28%的表决权，因此李阳、郭耀辉合计控制发行人的表决权比例为 28.27%。

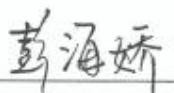
截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州慧智微电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



彭海娇



张辉

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2023 年 9 月 12 日

